



芯片在板烧注意事项

Ver1.0

2023.02.07



目录

一、在板烧注意事项.....	- 3 -
1. 适用于全系列芯片.....	- 3 -
1.1 并联电容规则.....	- 3 -
2. 特殊芯片处理.....	- 3 -
2.1 HS26P10.....	- 3 -
图 1.1.....	- 3 -
图 1.2.....	- 4 -



一、在板烧注意事项

1. 适用于全系列芯片

1.1 并联电容规则

- VDD 管脚对地增加电容最大容量限制值为 **470uF**
- SCK、SDA 管脚对地增加电容最大容量限制值为 **200pF**
- MODEL 管脚允许对地增加 **100nF** 的电容，**但需要联系工程师修改烧写时序**

2. 特殊芯片处理

2.1 HS26P10

——不限于某一封装

下图 1.1 所示 HS26P10-SOP8 封装的芯片管脚图，其中红色字体标出的管脚为烧写引脚；PIN6 为烧写 SCK 引脚，同时复用为模拟输入通道 1，PIN5 为烧写 MODEL 引脚，同时复用为模拟输入通道 0。下图 1.2 将采用该芯片进行演示。

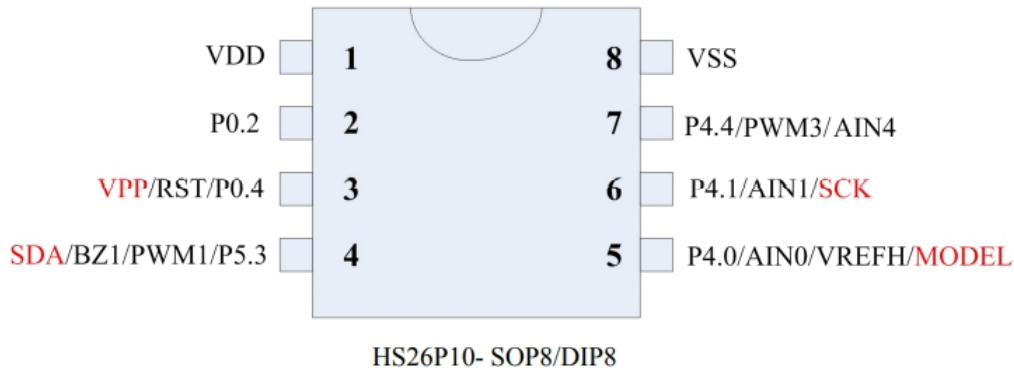


图 1.1

下图 1.2 为 HS26P10 的 SCK 引脚对地并联 100nF 电容后的实际烧写波形图；其中黄色波形为 SCK 信号，蓝色波形为 SDA 信号；SCK 引脚受电容充放电影响导致其电平周期不满足 SDA 传输速率，即烧写电平信号不完整导致烧写失败

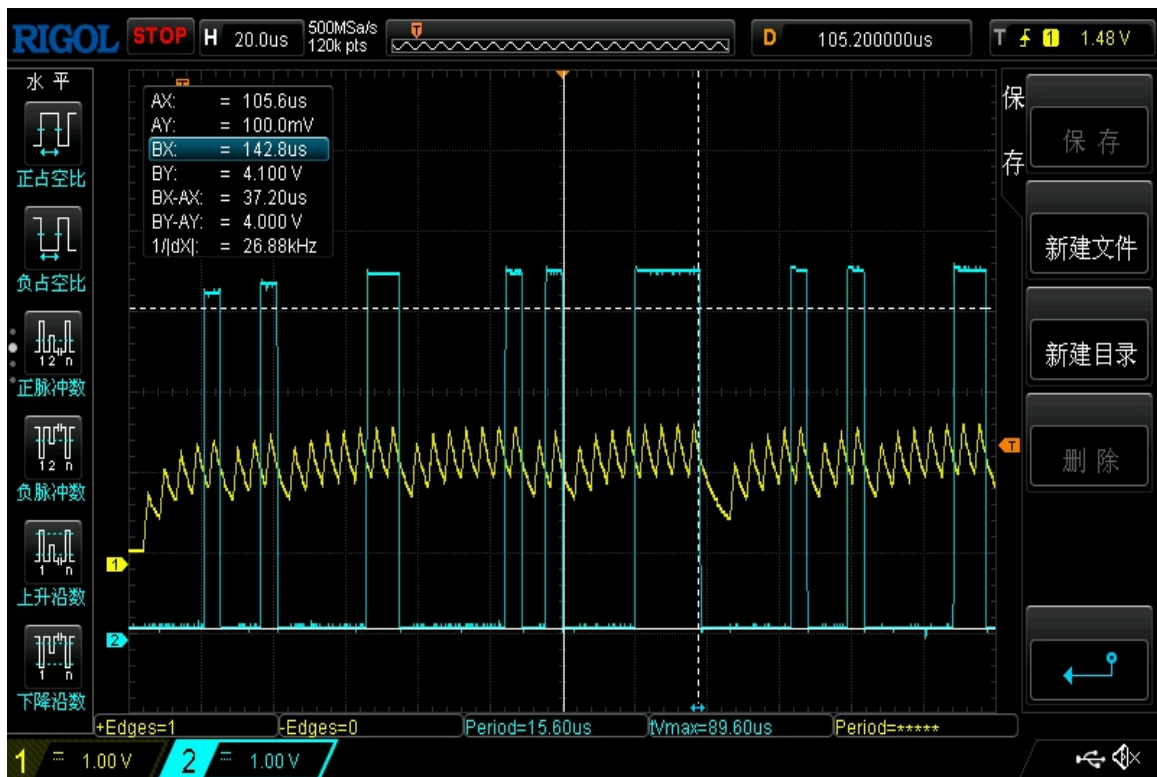


图 1.2

注意：

(1)、HS26P10 类，不限于某一封装的烧写引脚在实际应用为 ADC 或复用为其他功能时，不可并联常见的 100nF 滤波电容，否则将导致烧写失败；

(2)、如需使用电容

建议将电容并联用于 MODEL 引脚，同时需要联系工程师修改烧写时序。